

## 2L ラボ用遊星真空ミキサー カンチレバー昇降バケット式

商品番号: JL02



### 前書き

均一な電池スラリーの分散や最大1,200,000 cPの高粘度処理に対応する、カンチレバー昇降バケットを備えた2Lラボ用遊星真空ミキサーです。調整可能な加熱・冷却機能、精密なデュアル攪拌、研究開発規模の生産に適した堅牢なステンレス製構造を備えています。

### [詳細を学ぶ](#)

| 用途                | 説明                                                  | 主な利点                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 電池電極スラリー調製        | リチウムイオン電池等の開発ワークフローに向け、活物質粉末、導電助剤、バインダー、液体媒体を混合します。 | コーティングや電極処理の前に、一貫した粉体の濡れと均一なスラリー分布を促進します。 |
| 高粘度電池配合           | 最大1,200,000 cPの指定粘度範囲内で、移動が困難な高粘度配合を処理します。          | 低速の遊星混合と高速分散を組み合わせ、要求の厳しいレオロジーに対応します。     |
| 導電材料の分散           | 歯付き分散ディスクを使用して、カーボン材料やその他の微細添加剤をバインダーまたは溶媒系に分散させます。 | 凝集を抑え、バッチ全体での添加剤の分布を改善します。                |
| 先端材料研究            | ラボスケールでセラミックス、複合材料、機能性粉末、特殊材料の配合を開発します。             | 混合および分散パラメータを調整し、制御された実験を可能にします。          |
| 粉末冶金用バインダーおよびペースト | ペースト開発やプロセス試験のために、粉末と液体またはバインダー相を組み合わせます。           | 大型の生産用ミキサーを必要とせず、再現性の高い小規模バッチ混合をサポートします。  |
| セラミックススラリー開発      | 鋳造、コーティング、成形、または関連するラボ評価用に、粘性のあるセラミックススラリーを調製します。   | 大きな機械的エネルギーを必要とする材料に対して、強力な攪拌を提供します。      |
| 温度に敏感な配合          | お客様が用意された循環システムを容器壁面および底面ジャケットに接続し、加熱または冷却を行います。    | 混合および分散中に、より適切な処理温度を維持するのに役立ちます。          |
| 学術およびパイロットラボ作業    | 研究室での配合スクリーニング、パラメータ研究、スケールアップ準備を実施します。             | 有用なバッチ容量と柔軟な速度調整、扱いやすい容器操作を兼ね備えています。      |

| 仕様グループ  | パラメータ       | 値                                       |
|---------|-------------|-----------------------------------------|
| 製品識別    | モデル         | JL02                                    |
| 容器アセンブリ | 設計全容量       | 3.8L                                    |
| 容器アセンブリ | 有効容量        | 1.2L-2L                                 |
| 容器アセンブリ | 容器内径        | 180mm                                   |
| 容器アセンブリ | 容器内深さ       | 150mm                                   |
| 容器アセンブリ | 接液部材質       | 304ステンレス鋼                               |
| 容器アセンブリ | 温度制御ジャケット形式 | 容器壁面用単層ジャケット（冷却/加熱）、容器底面用単層ジャケット（冷却/加熱） |

| 仕様グループ  | パラメータ           | 値                                            |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|
| 容器アセンブリ | 温度制御ジャケット接続     | G3/8", クイックオープンユニオンカップリング付き; ジャケット耐圧 ≤0.4MPa |
| 容器アセンブリ | 温度制御ジャケット循環システム | お客様にてご用意                                     |
| 容器アセンブリ | 推奨ジャケット入口水温     | ≤8°C                                         |
| 容器アセンブリ | 推奨冷却水流量         | >3.5L/min                                    |
| 容器アセンブリ | 排出形式            | 排出バックルなし                                     |
| 容器アセンブリ | 設計周囲温度          | -10~+120°C                                   |
| 容器アセンブリ | 移動方法            | キャスターなし、手動取り扱い                               |
| 混合アセンブリ | 動作周波数           | 5-50Hz                                       |
| 混合アセンブリ | 混合出力            | 0.75kW                                       |
| 混合アセンブリ | 混合回転速度          | 8-76rpm                                      |
| 混合アセンブリ | 遊星ボックス回転速度      | 5-52rpm                                      |
| 混合アセンブリ | 混合ブレード直径        | 94mm                                         |
| 混合アセンブリ | 混合ブレードスタイル      | 可変断面スパイラルツイストタイプ、90°スパイラルライン                 |
| 混合アセンブリ | 混合ブレード材質        | 304ステンレス鋼                                    |
| 混合アセンブリ | 混合ブレード線速度       | /                                            |
| 混合アセンブリ | 混合ブレード数         | 2個                                           |
| 混合アセンブリ | ブレードピッチ         | 6±1mm                                        |
| 混合アセンブリ | ブレードと容器壁面の距離    | 3+1mm                                        |
| 混合アセンブリ | ブレードと容器底面の距離    | 2-3mm                                        |
| 分散アセンブリ | 動作周波数           | 5-50Hz                                       |
| 分散アセンブリ | 分散出力            | 1.1kW                                        |
| 分散アセンブリ | 分散回転速度          | 450-4450rpm                                  |
| 分散アセンブリ | 分散ディスク直径        | 60mm                                         |
| 分散アセンブリ | 分散ディスクスタイル      | 歯付き                                          |
| 分散アセンブリ | 分散ディスク材質        | 304ステンレス鋼                                    |
| 分散アセンブリ | 分散線速度           | 1.3-13m/s                                    |
| 分散アセンブリ | 分散ディスク数         | 1個                                           |
| 分散アセンブリ | 分散シャフト数         | 1本                                           |